

杭州华塑科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年08月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向光大银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币1.00亿元(含)的综合授信额度，现将有关情况公告如下：

一、综合授信的基本情况

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向光大银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币1.00亿元(含)的综合授信额度，其担保方式为信用授信，授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。授权有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限内，授信额度可循环滚动使用。

本次申请的综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需要来确定。

为保证上述事项的有序开展，董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理上述事项后续具体工作并签署相关文件。

二、备查文件

- 第二届董事会第五次会议决议；
- 第二届监事会第五次会议决议；

3、第二届审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司

董事会

2024年08月29日